

Transfer Molding System

Model YPM1080-SP



**Transfer molding system utilizing
high fluidity resin realizing high quality molding for substrates**

用高流动性树脂实现高质量成形的 基板专用注塑成形设备

产品信息



中文

- 简单的模具构造，使得品种切换更容易，成本更低
- 采用了可对应MUF成形的构造
- 使用高流动性树脂成型时，边缘浇口方法可防止树脂泄漏
- 可通过增设或减少模组的方式灵活应对产能变化



SPECIFICATION

Items		Unit	Description			
机型		—	YPM1080-SP			
框架・基板类型		—	基板			
基板尺寸	长度	mm	150—300			
	宽度	mm	75—100			
树脂	径	mm	φ 14, 16			
	长度	mm	15.4—35.0			
机械时间		sec	Approximately 40 (45*)			
外形尺寸	模组数量	module	1	2	3	4
	宽度	mm	2,540	3,220	3,900	4,580
	纵深	mm	2,000	2,000	2,000	2,000
	高度	mm	1,980	1,980	1,980	1,980
重量		ton	6.0 (6.1*)	9.1 (9.3*)	12.2 (12.5*)	15.3 (15.7*)
每模成形基板数量		workpiece	2	4	6	8
进料盒空间		mm	440			
出料盒空间 (插片式收料方式)		mm	440			
合模压力		kN/(tf)	98.0—784.0/10.0—80.0			
注塑压力		kN/(tf)	3.92—49.0/0.4—5.0 (2 step pressure setting)			
品种切换方式		—	采用KIT更换方式			
可以安装的模具		—	YPM1080-SP租用模具			

- ・ 以上数据为本公司标准机型时的规格
- ・ 以上规格根据实际需要可能有改良变更的可能
- ・ 如有其他特殊规格要求，另行协商
- ・ 如果使用edge gate方法，请告知我们产品尺寸和树脂信息。
- ・ *的值是用于分离膜规格



东和半导体设备（上海）有限公司
中国上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座20A
TEL 021-6888-6860

Website



Inquiry contact



TOWA（本公司商标）， 是TOWA株式会社的商标或注册商标。

Overseas Sales Contacts

Japan/Headquarters

TOWA Corporation

China

TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
TOWA Taiwan Co., Ltd.

Korea

TOWA Korea Co., Ltd.

Singapore

TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

Malaysia

TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

Philippines

TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp.

Thailand

TOWA THAI COMPANY LIMITED

India

TOWA SEMICONDUCTOR INDIA
PRIVATE LIMITED

Germany

TOWA Europe GmbH

Netherlands

TOWA Europe B.V.

the United States

TOWA USA Corporation

20250401-004-HQ